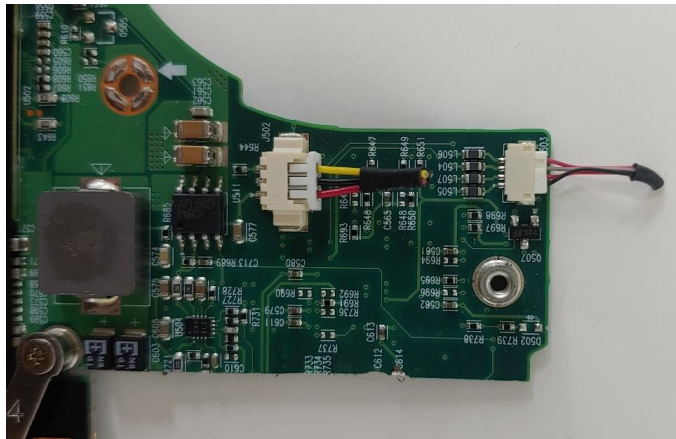


전선 커넥터 시편 전처리

목적: 전선 커넥터의 결합 단면 관찰

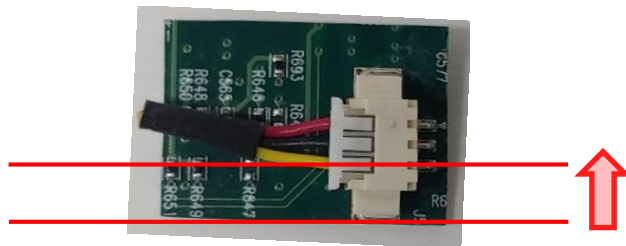
< 주요 기술 >

1. 커넥터와 같이 결합된 부분을 보기 위한 Target 설정 연마
2. Target의 정확한 위치를 보기 위한 정밀 Cutting



샘플 이미지 (전선 커넥터)

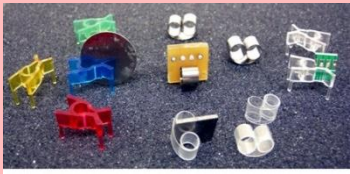
1. 샘플 채취 (Cutting)



전선 커넥터와 같이 결합의 상태, 내부의 핀 등 정확한 수치를 얻기 위해서는 Target 위치에 수평하게 정확한 Cutting이 필요함.

2. Mounting – Cold Mounting

※분석 진행 과정에서 재료에 따라 어떤 Mounting을 선택하는지가 매우 중요!



TIP!

시편을 얇거나 세워야하는 경우, 위의 클립을 이용하면 좋다.



VacuPrep – 진공 장비
마운팅시 기포 제거로
분석 과정에 도움.

내부 확인하기 위해 투명도를 높이려면 에폭시 타입을 추천.

EpoxySet 제품의 경우, **높은 투명도**로 Target 정확히 확인 가능하며 경화 시간이 길어 마운팅 시, 빠른 수축을 방지해 샘플과 몰드 사이의 벌어짐 현상 방지.

3. Grinding/Polishing – Auto Polisher

Step	Grinding				Polishing	
	1	2	3	4	5	6
Abrasive	320Grit (P-400)	600Grit (P-1200)	800Grit (P-2400)	1200Grit (P-4000)	3 μ m	0.05 μ m
Type	SiC	SiC	SiC	SiC	Diamond	FinalPrep
Carrier	Abrasive Disc	Abrasive Disc	Abrasive Disc	Abrasive Disc	Suspension	Solution
Polishing Cloth	-	-	-	-	White Label	Chem-POL
Coolant	Water	Water	Water	Water	GreenLube	-
Platen Speed(RPM) / Direction	100 /Comp	100 /Comp	100 /Comp	100 /Comp	100 /Contra	100 / Contra
Sample Speed (RPM)	90	90	90	90	90	90
Force (lbF)	3	3	4	4	3	3
Time (min)	Until Target	Until Target	2'00"	2'00"	3'00"	3'00"

TIP!

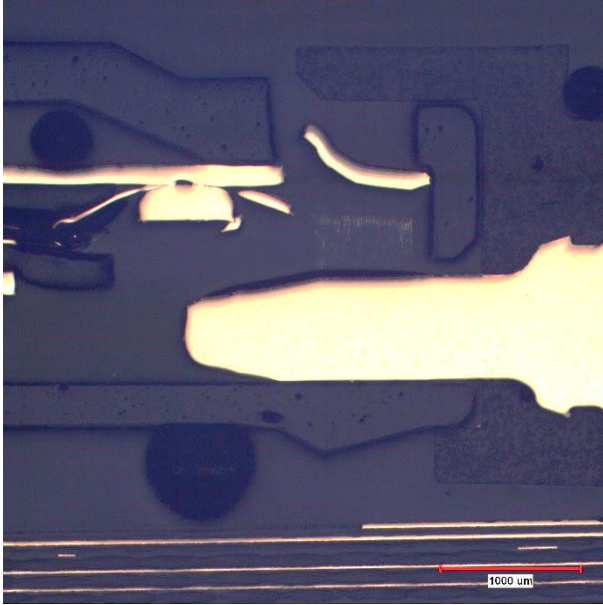
Target 까지의 거리에 따라 시작하는 SiC Paper를 선택,
Target은 600Grit(P-1200)에서 맞춘다.

※위의 Recipe는 8" Platen, 32mm 몰드 기준입니다. 그 외의 규격에 대해서는 문의주시면 Recipe, item 번호 등 알려드립니다.

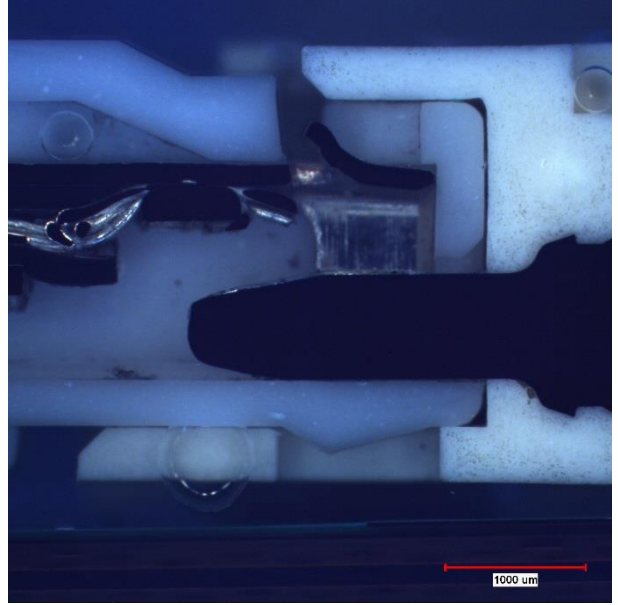
MetPrep3/ PH-3 + AD-5



4. 분석 결과



x25 - BF



x25 - DF

진행한 전선 커넥터는 전선과 핀이 안쪽에서 연결되어 있다.
정확하게 Line을 맞춰 Cutting 진행 후 Target까지 공정 순서에
맞춰 진행한다면 커넥터 종류에 따라 Male-Female 결합 상태를 확인하여
불량, 핀의 접촉 깊이 등 다양한 결과를 관찰할 수 있다.



경기도 성남시 중원구 상대원동 선택시티 1차 507호
Tel : 031-777-1277 / Fax : 031-777-1288
E-mail : aht@chinwoo.co.kr_Web site :http://www.chinwoo.co.kr

시편준비에 어려움을 겪고 계신 고객 분들을 지원 हे드리기 위해 시편제조기술센터(OPEN LAB.) 을 운영하고, 매일 정기교육을 실시하고 있사오니 언제든지 주저 마시고 활용해 주시기 바랍니다.